

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号:2026-062

深圳市景旺电子股份有限公司

关于调整珠海金湾基地扩产投资计划暨增加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：**超高多层PCB智能制造项目（以下简称“该项目”或“本项目”）。
- 投资金额：**预计总投资人民币43.88亿元，将根据项目实际进展分阶段投入，最终以项目建设实际投资开支为准。
- 本次投资交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次投资事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
- 相关风险提示：**本项目是在公司目前条件下结合外部市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预估存在差距。项目实施过程中可能会面临宏观经济、行业政策、市场波动等因素影响，可能存在达不到预期效益的风险。本项目的投资金额、建设周期等为预估数，实际建设过程中存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

一、 对外投资概述

（一） 本次交易概况

1、 本次交易概况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“景旺电子”）为加速在 AI 算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI 端侧应用等领域的高性能 PCB 产品

布局,抢抓 AI 浪潮下全球科技产业供应链重构之机遇,增强核心竞争力,于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于珠海金湾基地扩产投资计划的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金人民币 50 亿元对景旺电子珠海金湾基地进行扩产投资,以满足 AI 算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI 端侧应用等领域全球客户的中长期、高标准需求,提升公司在高端产品的市场竞争优势。其中拟利用储备用地增加投资人民币 8 亿元强化关键工序产能。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日、2025 年 8 月 25 日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及指定信息披露媒体上的相关公告。

为进一步提升公司在通信与数据基础设施领域的竞争优势、满足行业技术发展趋势及全球 AI 算力领先客户的需求,经审慎评估,公司拟对上述“关键工序产能强化投资项目”变更为“超高多层 PCB 智能制造项目”,预计该项目总投资人民币 43.88 亿元,资金来源为公司自有及自筹资金等多种方式。

2、 本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☐ 增资现有公司 (☐ 同比例 ☐ 非同比例) —增资前标的公司类型: ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☒ 投资新项目 ☐ 其他:
投资标的名称	超高多层 PCB 智能制造项目
投资金额	☒ 已确定,具体金额: 人民币 43.88 亿元
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☒ 其他: 自筹资金 ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他: _____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

(二) 董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整珠海金湾基地扩产投资计划暨

增加投资的议案》。

本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，相同类别下同一标的累计 12 个月内经董事会审议的对外投资金额已超公司经审计净资产的 50%，本事项尚需提交股东会审议。

二、 投资标的基本情况

（一） 投资标的概况

本项目由全资子公司景旺电子科技（珠海）有限公司具体实施，拟在珠海金湾基地园区内新建超高多层 PCB 智能制造项目，利用储备用地建设的厂房引进国内外先进生产设备，完善配套公用、辅助设施、环保处理设施，以扩充公司在高端高速超高多层 PCB 的产能。

（二） 投资标的的信息

（1） 项目基本情况

投资类型	☒ 投资新项目
项目名称	超高多层 PCB 智能制造项目
项目主要内容	围绕高端市场需求，建设超高多层 PCB 智能制造项目
建设地点	珠海金湾基地园区内
项目总投资金额（亿元）	43.88（最终以项目建设实际投资开支为准）
上市公司投资金额（亿元）	43.88（最终以项目建设实际投资开支为准）
项目建设期（月）	24
是否属于主营业务范围	☒ 是 ☐ 否

（2） 各主要投资方出资情况

公司拟通过自有及自筹资金等多种方式筹措本次项目资金。

（3） 项目目前进展情况

本项目为原“关键工序产能强化投资项目”变更调整，公司于 2026 年年初已利用储备用地开始建设主体厂房，截至目前主体厂房尚在建设过程中。

（4）项目市场定位及可行性分析

过去及未来一段时期内, AI 算力提升是 PCB 行业结构性增长的核心驱动力。Prismark 预计, 来自 AI 的强劲需求催化下, 2025-2030 年, AI 算力数据基础设施 PCB 的市场规模复合增长率将达到 21.4%, 其中 18 层以上多层板、HDI 板、封装基板等高端产品的增速最快, 复合增长率分别达到 31.5%、27.8%和 24.2%。未来五年, 服务器/存储/AI 领域 PCB 的层数和对电性能的要求将提升明显。

公司拟通过自有及自筹资金等多种方式筹措本次项目资金, 资金来源稳定可控, 能够充分满足项目建设及后续运营需求。本项目的建设符合国家相关产业政策, 符合广东省产业结构调整方向以及广东珠海经济技术开发区产业发展方向, 符合国家的法律法规、区域经济发展政策和行业准入标准。公司与全球主流 AI 计算基础设施领先企业的合作持续深化, 在技术储备、高端产能、产品稳定性与一致性等方面构建了多维优势, 可有效承接并消化本次新增产能。

三、 本次对外投资对公司的影响

本次投资是公司结合整体运营规划与项目建设实际需要进行必要的调整, 有利于公司加速把握 AI 浪潮驱动下 PCB 行业结构性增长新阶段的发展机遇, 提升公司在 AI 算力、高速网络通讯等领域的高性能 PCB 产品供应能力, 满足客户的中长期、高标准需求, 增强核心竞争力与市场地位, 进一步扩大公司经营效益。本次投资资金来源为自有资金及自筹资金等多种方式, 公司将根据项目具体需要分期投入投资资金, 不会对公司现有业务的正常开展及公司财务状况、经营成果产生重大影响, 不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。从长期来看, 对公司未来发展和经营收益具有积极推动作用。

四、 对外投资的风险分析

1、本次投资项目在实施过程中, 若宏观经济波动、行业政策调整、市场需求不及预期或产品价格出现波动, 以及工程建设进度、设备采购及安装调试未达预期, 均可能影响产能释放与项目预期效益。公司将组建专业的项目管理团队, 制定详细的项目实施计划和应急预案, 加强与供应商及承建商等合作伙伴的沟通协调, 严格控制项目进度和成本管理, 确保项目按计划推进。

2、本次项目投资资金来源包括但不限于自有及自筹资金等多种方式，可能面临一定的资金筹措压力，存在一定的融资风险。公司资信情况良好，银行授信额度充足，没有对公司经营产生重大影响的对外担保。公司将根据项目建设进度和资金需求，与合作厂商充分协商更友好的付款方式，根据需要科学规划融资方案，优化资本结构，合理控制融资成本和财务风险，确保足够的资金投入以满足项目建设需求。

3、本次投资项目尚需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，能否通过相关政府审批存在不确定性。项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。公司将与地方政府、相关部门密切沟通，推动项目实施有关的审批工作。

4、本次投资项目的投资金额、建设周期等为预估数，实际建设过程中存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026年8月22日